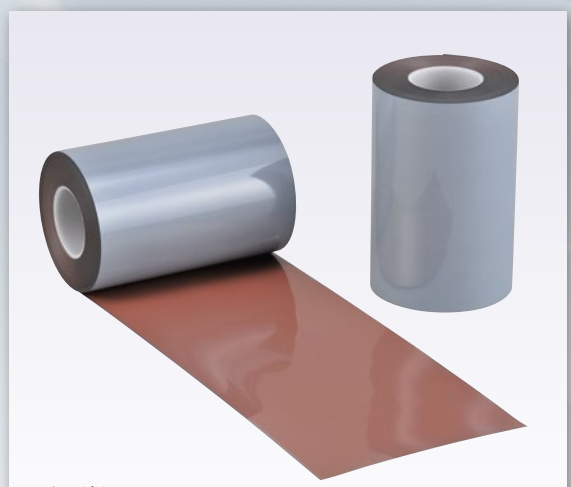
TATSUTA

高段差基板用シールドフィルム



※イメージはSF-PC-6000-U1

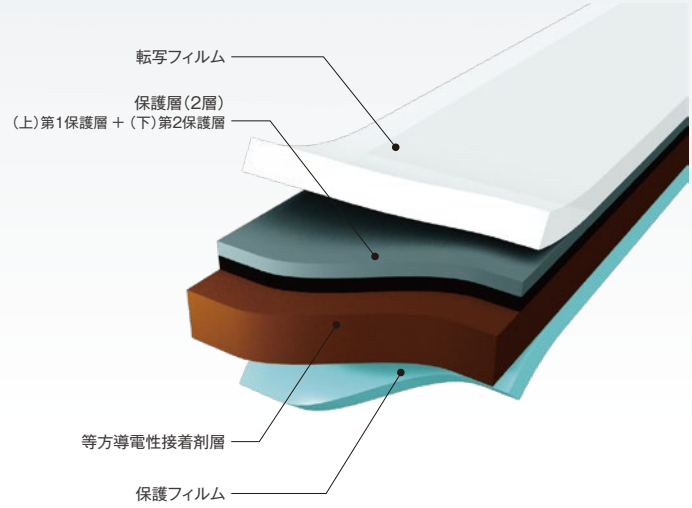
SF-PC®6000-U1/-U1N

高段差R/F基板への追従性が高いシールドフィルム

リジッド部とFPC部を跨ってシールドフィルムを貼る必要がある場合、
SF-PC6000-U1/-U1Nは、段差への高い追従性を発揮します。

特 徴

- **高段差追従性**
  高段差（300μm以上※参考値）での追従性を向上
- **OSP耐性**
  シールドフィルム貼付け後のOSP処理に対応可能
- **シールド特性、屈曲特性は他シールドフィルムと同等**
- **転写フィルムの軽剥離化**（SF-PC6000-U1N）
  転写フィルム剥離時の作業性を向上



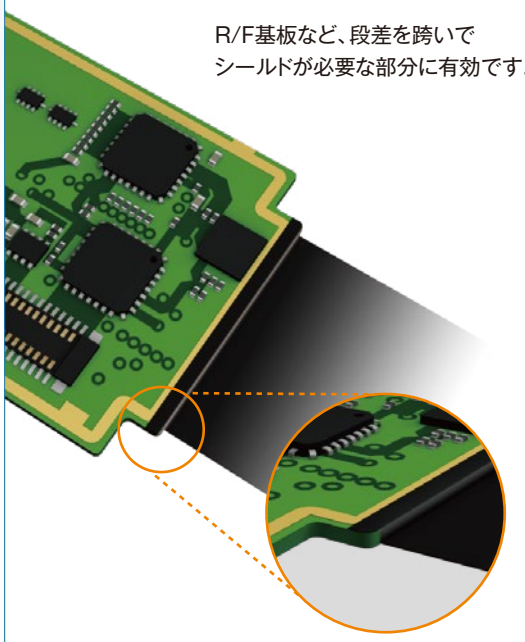
UL登録内容

UL94 VTM-0（Kapton50Hとの組み合わせ）
※Kapton®は米国デュポン社の登録商標です

こんなところで活躍します

段差部分の追従性を向上

R/F基板など、段差を跨いで
シールドが必要な部分に有効です。



代表スペック		SF-PC6000-UI/-UIN
転写フィルム厚み		57μm（白色）/60μm（白色）
製品総厚み（プレス後）		16μm
	保護層厚み	6μm
	等方導電性接着剤層厚み	10μm
接着強度		3.0N/cm以上
製品ライフ（冷蔵）		4ヶ月

タツタ電線株式会社　システム・エレクトロニクス事業本部　〒619-0216 京都府木津川市州見台6丁目5番1号　TEL：0774-66-5551 FAX：0774-66-5556　URL http://tatsuta.co.jp